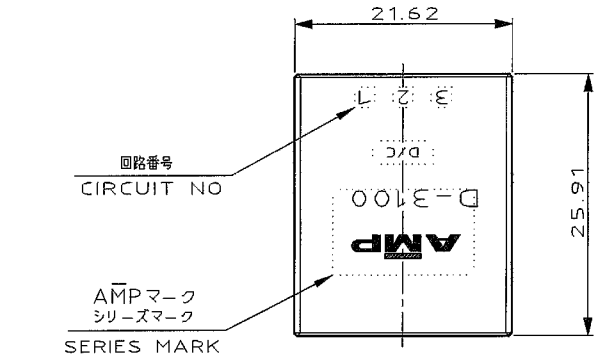
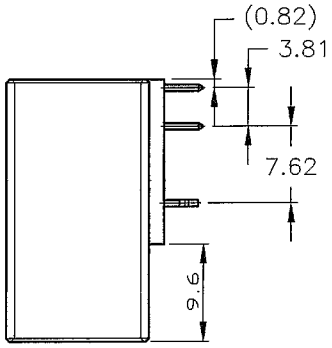
NUMBER 178303

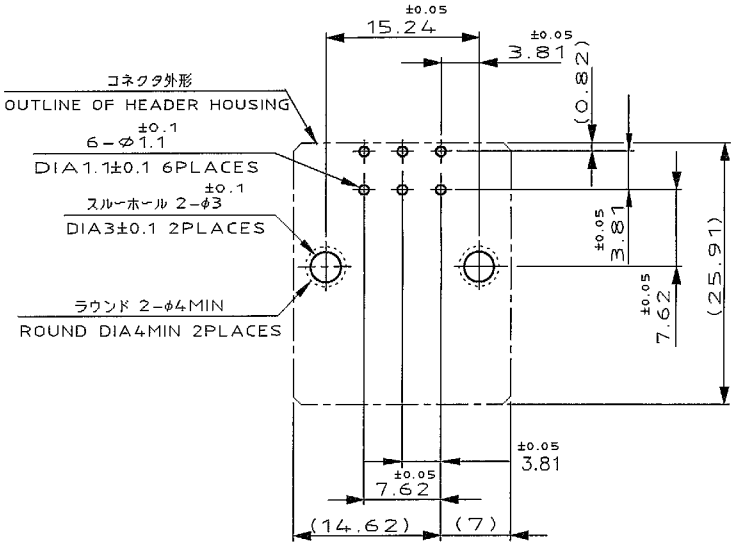
3rd ANGLE PROJECTION

METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT



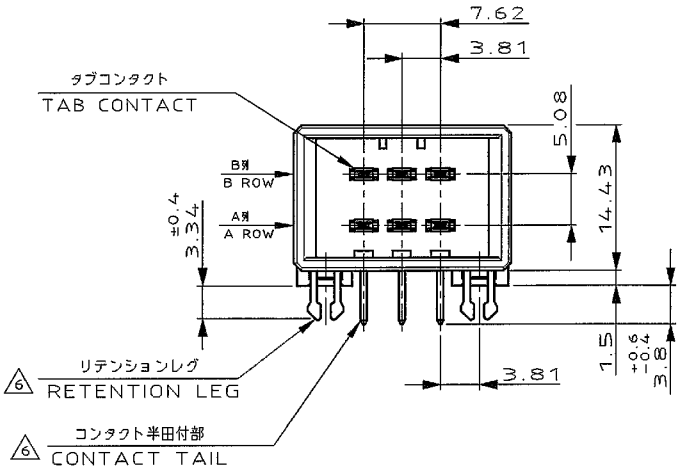




推奨基板取付け穴寸法

PC 基板厚:1.6±0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS:1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)



NOTES

1. MATERIAL:HOUSING:GLASS FILED THERMO PLASTIC,POLYESTER
CONTACT:COPPER ALLOY
RETENTION LEG:COPPER ALLOY
2. FINISH(CONTACT AREA):0.38μmMIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
3. FINISH(CONTACT AREA):0.76μmMIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
4. FINISH(CONTACT AREA):2.0 μmMIN TIN PLATED OVER NICKEL
~~5. FINISH(RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL~~
6. FINISH(RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
2. めっき: コンタクト: 全面Ni下地 接触部:0.38μm MIN金めっき
3. めっき: コンタクト: 全面Ni下地 接触部:0.76μm MIN金めっき
4. めっき: コンタクト: 全面Ni下地 接触部:2.0 μm MINスズめっき
~~5. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部 : ニッケル下地の上に半田めっき~~
6. めっき リテンションレグとコンタクト半田付部 : ニッケル下地の上にスズめっき

6	4	178303-5
6	3	178303-3
6	2	178303-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE
C	REVISED(FJD0-0039-03)	TS	S.M	1/2 '03
B	REVISED(FJD0-0097-03)	TS	S.M	4/15 '03
A	REVISED (FJ00-2183-95)	KI	SM	3-23 '95
0	RELEASED (J-1184)	NM	H.O S.M	3-4 '92

Copyright © 1991
AMP(Japan) LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.

tyco Electronics — Tyco Electronics AMP K.K Kawasaki,Japan

WIRE RANGE mm²(AWG -)	INSULATION DIA -- mm⌀	NAME ダイナミック D3100 水平タイプ 6 極 ヘッダーアセンブリー 6 POS DOUBLE ROW HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100	
MATERIAL SEE NOTE 注記参照	FINISH SEE NOTE 注記参照		
DR. 14 JUN 91 N.Matsubara	DE. 14 JUN 91 N.Matsubara	一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下 ±0.3; 10超過 30以下 ±0.4; 30超過100以下 ±0.45; 角度 ±3°	SIZE A3 / LOC J / NUMBER C-178303
CHK. 24/FEB/'92 Y.Obata	APP. 4/MAR/'92 S.MANABE		SCALE 2-1 / REV. C / SHEET 1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面

PRINT DIST

AMP-J
REV.10/'83